Inside (from above)/内部(上から)

<Japanease>

-The layout of the main devices on each board is shown below. ・各基板の主要デバイスのレイアウトを以下に示します。

-Parts such as LDOs, connectors, transistors, inductors, resistors, capacitors, etc ·LDO、コネクタ、トランジスタ、インダクタ、抵抗、コンデンサ、等の部品は説明割愛します。

AH00ICB

AH00ICB 1

← Same/←同じ











External (bottom)/外部(底面)

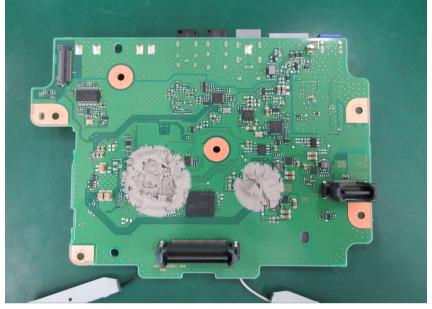
外部(背面)

Front/表



← Same/←同じ

Rear/裏

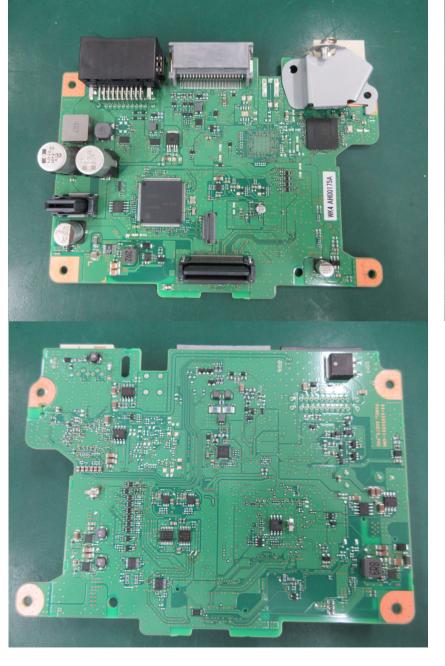


← Same/←同じ

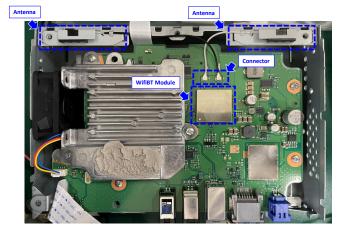
[Audio_Power PWB]

[Audio_Pre PWB]





WG ARION CONTROL OF THE CONTROL OF T



Wifi/BT Module with cover(TOP)



Wifi/BT Module(BOTTOM)



Wifi/BT Module without cover(TOP)

